

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

编号：2026-002

长沙景嘉微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金资管、长城基金、开源证券、万永投资（排名不分先后）
时间	2026年7月6日-7日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁 董事会秘书周振武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司自成立以来致力于信息探测、信息处理和综合应用，为客户提供高品质、高可靠的产品、解决方案和服务。公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。</p> <p>公司芯片产品主要为图形处理芯片（GPU）和边端侧 AI SoC 芯片。</p> <p>公司成功研发了以 JM5400、JM7 系列、JM9 系列和 JM11 系列为代表的一系列 GPU 芯片，支持 Windows、Linux 及国产主流操作系统，可广泛应用于服务器、图形工作站、台式机、笔记本等设备，已在政务、电信、电力、能源、金融、轨交等多领</p>

域实现应用，形成了云桌面、CAD 工业设计软件、BIM 建筑信息模型设计、3D 地理信息渲染、工业数字孪生等场景的完整解决方案。

公司控股子公司自主研发的边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列产品采用高集成度的单芯片设计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元，以其 64TOPS@INT8 的峰值算力、低功耗、灵活计算精度、高实时与低延迟等特性，精准地切入了端侧 AI 应用的核心需求，为客户提供了可靠、高效的算力解决方案；主要面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场，可以涵盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。

目前，公司坚定看好高性能 GPU 与边端侧 AI SoC 未来广阔的发展前景，凭借深厚的技术积淀与研发优势，紧扣“十五五”规划，加强研发投入，优化研发资源配置，推动“高性能 GPU+边端侧 AI SoC 芯片”双轮驱动战略，丰富产品矩阵，以构建覆盖“云一边一端”的算力闭环。同时，公司致力于打造安全可控的国产化算力底座，并通过投资等方式深度融合芯片技术与国防、低空经济等应用场景，拓展具身智能及边缘计算等通用市场，形成“芯片一场景一生态”的协同发展模式。

二、座谈交流环节

1、诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列现在进度如何？

CH37 系列边端侧 AI SoC 及配套评估板，充分满足终端应用轻量化、低功耗、高实时响应的核心需求，搭载高性能 AI 计算单元，可高效完成多模态数据融合处理，稳定支撑机器视觉、智能感知、实时决策控制等 AI 算法，广泛适配工业、服务、特种机器人等各类终端场景。

诚恒微与众多机器人整机厂商、算法企业、解决方案服务商深度洽谈，围绕芯片适配、联合研发、场景落地、产业化合作等方向对接需求，目前 CH37 系列产品客户导入工作顺利，并同步

完成配套 SDK 软件的开发和发布。

2、公司 2026 年二季度经营和研发情况如何？

公司当前经营稳健，聚焦 GPU 及 AI SoC 领域，持续推出云桌面、CAD 工业设计软件、BIM 建筑信息模型设计、3D 地理信息渲染、工业数字孪生及机器人、AI 盒子等应用场景解决方案，并同步推进产品研发与市场拓展。

3、公司高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目的型号 2 芯片侧重推训，公司是如何看待推理与训练的差异？

推理与训练的核心差异不仅在于算力需求，更在于软件生态和部署节奏。训练是高精度、高带宽、强互联的“重载”场景，依赖密集浮点计算与大规模分布式通信；推理则追求低延迟、高吞吐与极致能效，普遍采用低精度量化、结构化稀疏等轻量级优化。若没有适配良好的软件栈，硬件推训一体极易沦为参数折中，无法真正释放效率。

因此，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目型号 2 芯片的差异化路径通过开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用落地。

4、关注到公司已通过投资布局商业航天，同时想了解，公司现有业务与这一领域是否也存在潜在的协同可能？未来与投资标的之间的互动，是仅限于财务投资，还是会有更深层次的业务合作？

公司此次投资是我们在商业航天产业链上游的一次积极探索，希望通过这种方式，更近距离地理解商业航天领域的发展趋势与技术需求。

在业务协同方面，公司基于在 GPU 与 AI SoC 芯片等领域的

	<p>技术优势，结合投资标的在卫星平台与整星研发制造方面的能力，双方以平等互利、优势互补为基础，有望推动产品深度融合，共同服务商业航天与国防安全等国家重点领域，从而为双方创造更大的商业机会和市场价值。目前尚未形成订单，相关业务进展存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。</p> <p>至于与投资标的未来的互动深度，我们更愿意将其定位为“以投资为纽带，以协同为目标”，未来双方在技术对接、产品适配等方面将持续探索合作空间。</p>
附件清单(如有)	
日期	2026年7月7日